

2006 年度精密工学会春季大会学術講演会講演募集について

1. 期 日 平成18年3月15日(水)～17日(金)
2. 会 場 東京理科大学 野田キャンパス(千葉県野田市山崎 2641)
3. 講演申込開始 平成17年10月12日(水) 9時 から
4. 講演申込締切 平成17年11月17日(木) 17時まで
5. 講演申込費締切日 平成18年1月31日(火) までにお納め下さい。
6. 講演論文原稿締切 平成18年1月18日(水) 17時まで
7. 講演論文公開予定 平成18年3月1日(水)(講演論文集 CD-ROM 発行)

8. 登壇資格

講演者(登壇者)は個人会員(正会員・学生会員・学生会員 Web 級・名誉会員)に限ります。

- ・会員番号は名簿または会誌送付用封筒の宛名ラベルをご参照ください。
- ・未入会者で、講演希望の方は事前に入会手続きをお願い致します。会員番号が決定後、講演申込み願います。
- ・登壇者を筆頭に申し込んでいただきますが、講演原稿での著者の順番はこれに従う必要はありません。

9. 講演申込みについて

1) 講演申込みは、すべて精密工学会ホームページで受け付けます。締切期日を厳守してください。直ちにプログラム編成を行いますので、遅れたものは理由を問わず受け付けません。なお、精密工学会ホームページには講演募集に関する最新情報を掲載します。

2) 申込先

<http://www.jspe.or.jp> (精密工学会ホームページ)

(問合せ先) 社団法人精密工学会 2006 年度春季大会係

102-0073, 東京都千代田区九段北1-5-9 九段城和ビル2階 電話: 03-5226-5191

3) 講演申込みは1件につき1通登録してください。

4) 講演申込みには下記の費用が必要です。

正会員: 10,000 円(講演申込み費, 登壇者の大会参加費, 講演論文 CD-ROM, アブストラクト集合む。ただし、同一登壇者が2件目以降を申し込む場合については1件毎に5,000 円。)

学生会員, 学生会員 Web 級: 5,000 円(講演申込み費, 登壇者の大会参加費, アブストラクト集合む。ただし、同一登壇者が2件目以降を申し込む場合については1件毎に5,000 円。)

送金方法: 現金書留・郵便振替・銀行振込

郵便振替: 00180-3-6115, 社団法人精密工学会

銀行振込: みずほ銀行九段支店, 普通預金, 口座番号8047788, 社団法人精密工学会

5) 講演論文原稿は、PDF 原稿の書き方を参考に作成し、原稿締切日までに指定の web ページから提出してください。

6) 申し込んだ講演に対し、講演論文集原稿を期限までに提出し、著者のいずれかが会場で発表する必要があります。

7) 講演論文集および口頭発表に用いる言語は日本語または英語といたします。

8) 講演論文集 CD-ROM に収録された論文の著作権およびアブストラクト集に掲載される概要の著作権は社団法人精密工学会に帰属します。著作権には複製権, 翻案権, 翻訳権を含みます。

10. 講演申込の方法

1) 講演申込みは、インターネットの精密工学会ホームページで登録して下さい。

2) 講演申込みの項目は会員番号, 登壇者名, E-mail, 講演者名, 勤務先, 所属, 講演題目, 発表内容の分類(分類コード), キーワード, 使用言語, 使用機材, 会員資格, 連名者名, 勤務先, 当日出欠, 講演要旨(和文・英文), 講演申込費払込方法, 送金予定日, 連絡者氏名, 連絡先, 郵便番号, 住所, 勤務先, 所属, 電話, FAX です。

3) 同一題目第1報～第n報には必ず副題を入れてください。

4) 講演要旨はそのままアブストラクト集に収録します。講演要旨には図表は掲載できません。研究内容が把握できるわかりやすい文章を200字以内で書いてください。

JST(独立行政法人 科学技術振興機構)データベース用アブストラクトには、英文(100～200word程度)を掲載致します。講演論文については、大会終了半年後に掲載致します。

5) 分類・コード・キーワードの入力について

プログラム分類・コード・キーワードを別紙一覧表の通り設定しました。このキーワードはあくまでもセッションを構成するための「セッションキーワード」です。文献検索用のキーワードではありませんので、ご理解下さい。申込内容にふさわしい分類・コード・キーワードを選択し、所定欄に入力して下さい。オーガナイズドセッションに適切なものがない場合は分類のみを指定し、コードは「99」と入力して下さい(一般セッション)。一般セッションの場合、「キーワード」欄にはふさわしいキーワードを自由に入力して下さい。

・プログラム編成はキーワードで単純にソートされたものに基づいて行われます。

・キーワードは参加者からのご意見を反映し毎回変更される予定です。

1.1. 発表形式

本講演会の発表形式は、一般セッションとオーガナイズドセッションです。オーガナイズドセッションは一般セッションと同一形式です。以下のようなセッションを用意しましたので、内容にふさわしい研究発表を募集いたします。

<注意事項>

1) オーガナイズドセッションに申込みをする場合は、希望するセッションで指定された分類・コード・キーワードを所定欄に必ず入力して下さい。入力漏れ、入力ミスがありますとご希望のセッションにまわりませんのでご注意下さい。

2) プログラム編成上の最終責任は学術交流委員会が負っております。その結果、例えば、プログラム編成上オーガナイズドセッションとして申し込みをされなかった場合でもテーマに近い内容であればオーガナイズドセッションの中で発表していただく等の事態が起こり得ることを、予めご承知おきください。

1.2. 講演発表に関するお願い

1) 同一講演者が同一テーマ種別で3件以上の講演はご遠慮ください。

2) 同一題目で3件以上の講演はご遠慮ください。

3) 講演で使用可能な機器は OHP(紙媒体)・プロジェクタです。

本大会ではビデオデッキは会場に設置しておりません。

<プロジェクタ使用希望の方へ>

パソコンは各自でご持参ください。設定・調整は各講演のセッション開始前をお願いします。また予期せぬトラブルに備えてOHP原稿(紙媒体・透明シート不可)を用意されることをお勧めします。パソコン不良に伴う講演トラブルについては、講演者の責任で対処していただくようお願いいたします。

4) 講演申込時の題目・講演者(登壇者)の変更は原則として認めません。

1.3. ベストプレゼンテーション賞の授賞について

特に優れた講演発表について「ベストプレゼンテーション賞」を大会実行委員長より講演者にお出しします。各セッションの座長が審査しますが、選考基準は発表技術を中心とするものです。受賞者には大会終了後、表彰状をお送りいたします。

【分類】

A: 設計・生産システム B: 加工技術・材料 C: メカトロニクス・知的システム
 D: 計測・品質管理 E: 医用・福祉工学 F: 技術史・教育 G: 新領域, その他

分類	コード	OS/一般	セッションテーマ	オーガナイザー	キーワード
A	1	OS	形状モデリング	鈴木 宏正 (東京大)	形状情報処理, メッシュモデリング, 曲線・曲面・ソリッドモデリング, CAD
A	2	OS	デジタルスタイルデザイン	青山 英樹 (慶應大), 金井 理 (北海道大)	スタイルデザインのための3次元形状モデリング
A	3	OS	生産システムのエンジニアリング (基礎・理論)	荒井 栄司 (大阪大), 樋野 励 (名古屋大), 藤井 信忠 (東京大)	生産計画, 管理
A	4	OS	生産システムのエンジニアリング (応用・実践)	日比野 浩典 (機振協 技研), 谷水 義隆 (大阪府立大), 光行 恵司 (デンソー)	生産システム設計, 評価, 運用
A	5	OS	作業者配慮型生産支援環境	杉 正夫 (東京大), 小谷 潔 (東京大)	作業者配慮, 作業支援, 知的生産システム
A	6	OS	循環生産のためのライフサイクルエンジニアリング	高田 祥三 (早稲田大), 梅田 靖 (大阪大), 増井 慶次郎 (産総研)	環境問題, ライフサイクル設計, ライフサイクルマネジメント, 環境配慮設計
A	7	OS	設計とサービス工学	下村 芳樹 (首都大東京), 新井 民夫 (東京大)	設計の高度化とサービス工学による高付加価値化
A	8	OS	モノづくりにおける最適化手法の活用	吉村 允孝 (京都市大), 西脇 真二 (京都市大), 宮下 朋之 (早稲田大), 北山 哲士 (金沢大), 泉井 一浩 (京都市大)	最適設計, システム最適化, モノづくり過程の最適化
A	99	一般	設計・生産システム一般		
B	1	OS	エコマシニング技術	中村 隆 (名古屋工業大), 鈴木 康夫 (静岡大)	エコマシニング, 環境対応生産, 環境負荷低減技術
B	2	OS	ナノ・マイクロ加工シミュレーション	稲村 豊四郎 (名古屋工大), 島田 尚一 (大阪電通大)	加工プロセスのシミュレーション
B	3	OS	工作機械の高速高精度化	幸田 盛堂 (大阪機工), 白瀬 敬一 (神戸大), 松原 厚 (京都市大)	工作機械, 高速主軸, 高速送り, 高速高精度制御, 精度補償
B	4	OS	高効率・高精度化のための切削工具	山根 八洲男 (広島大), 越智秋雄 (広島工業大), 臼杵 年 (島根大), 新谷 一博 (金沢工大)	切削工具, 切削加工技術
B	5	OS	穴加工および穴形状精度の測定	甲木 昭雄 (九州大)	穴加工, 穴精度, 測定
B	6	OS	エンドミル加工技術	岩部 洋育 (新潟大), 松村 隆 (東京電機大), 水垣 善夫 (九州工大), 安齋 正博 (理化学研)	エンドミル加工技術, 切削機構, 切削性能, 切削シミュレーション
B	7	OS	超音波振動を援用した加工技術	鬼鞍 宏猷 (九州大)	超音波振動切削, 超音波振動研削, 超音波振動研磨
B	8	OS	曲面・微細形状・機能性材料の超精密加工と計測	鈴木 浩文 (神戸大学), 山形 豊 (理化学研), 間 紀旺 (東北大)	曲面・微細形状, 機能性材料, 超精密加工, 超精密計測
B	9	OS	多軸制御加工計測	竹内 芳美 (大阪大)	多軸制御・加工
B	10	OS	金型加工技術	鈴木 裕 (九州工大)	精密金型, CAD/CAM, 微細金型
B	11	OS	研削現象とその機構	奥山 繁樹 (防衛大), 塚本 真也 (岡山大)	研削現象, 加工計測, 研削機構, 表面創成
B	12	OS	ナノ表面研削/ELID研削	大森 整 (理化学研), 伊藤 伸英 (茨城大), 林 偉民 (理化学研), 片平 和俊 (理化学研)	ナノ精度, 超精密研削, ELID, 鏡面加工
B	13	OS	超砥粒ホイールとその使用技術	呉 勇波 (秋田県立大), 福西 利夫 (アライドマテリアル), 立花 亨 (ミクロン精密)	超砥粒ホイール, ツルイーグ/ドレッシング, 研削, 研磨
B	14	OS	切断加工	諏訪部 仁 (金沢工大), 水野 雅裕 (岩手大)	切断技術
B	15	OS	砥粒加工の新展開	榎本 俊之 (大阪大), 谷 泰弘 (東京大), 北嶋 弘一 (関西大)	ポリシング, ラッピング, 固定砥粒加工工具, 超精密研磨加工, メカノケミカル研磨加工
B	16	OS	超平滑機械加工	安井 平司 (熊本大)	超平滑機械加工
B	17	OS	プラナリゼーションCMPとその応用	池野 順一 (埼玉大), 木下 正治 (ニッタ・ハース), 土肥 俊郎 (埼玉大)	プラナリゼーション, CMP, CMP応用, 超精密ポリシング, LSIデバイス
B	18	OS	複合研磨	山口 ひとみ (宇都宮大), 進村 武男 (宇都宮大)	磁場・電場援用研磨 (加工)
B	19	OS	電気エネルギー応用加工	武沢 英樹 (工学院大), 糸魚川 文広 (名古屋工大)	電気加工
B	20	OS	レーザ加工	大村 悦二 (大阪大), 伊藤 義郎 (長岡技科大)	レーザ加工, レーザ, 微細加工, 材料加工
B	21	OS	超精密マイクロ機械加工	森脇 俊道 (神戸大), 竹内 芳美 (大阪大), 社本 英二 (名古屋大)	マイクロ機械加工
B	22	OS	超精密物理化学加工	山内 和人 (大阪大), 山村 和也 (大阪大), 後藤 英和 (大阪大), 佐野 泰久 (大阪大)	超精密物理化学加工
B	23	OS	マイクロ・ナノ加工とその応用	諸貫 信行 (首都大東京), 森田 昇 (富山大), 池野 順一 (埼玉大), 梅原 徳次 (名古屋大)	マイクロ/ナノ加工, 表面微細構造, テクスチャ
B	24	OS	MEMS商業化技術	前田 龍太郎 (産総研), 伊藤 寿浩 (東京大), 内海 裕一 (兵庫県立大), 日暮 栄治 (東京大)	MEMSデバイス
B	25	OS	表面ナノ構造・ナノ計測	遠藤 勝義 (大阪大), 桑原 裕司 (大阪大), 押鐘 寧 (大阪大), 渡部 平司 (大阪大), 有馬 健太 (大阪大)	ナノファブリケーション, ナノストラクチャ, STM応用
B	26	OS	三次元造形	中本 剛 (千葉大)	三次元造形
B	27	OS	表面機能の形成と評価	諸貫 信行 (首都大東京), 森田 昇 (富山大)	機能表面の創製, 光学機能, 濡れ性
B	28	OS	表面トポグラフィー	笹島 和幸 (東京工大)	表面トポグラフィー
B	29	OS	機能性薄膜	安武 潔 (大阪大), 垣内 弘章 (大阪大), 大竹 尚登 (東京工大)	機能性薄膜
B	30	OS	加工機械のマイクロ化	山中 将 (東北大), 北原 時雄 (湘南工科大), 三井 公之 (慶應大)	マイクロ加工機
B	31	OS	機械加工における状態監視と制御	近藤 英二 (鹿児島大), 川合 忠雄 (大阪市立大), 佐藤 昌彦 (鳥取大)	加工状態監視, 研削加工モニタリング, 制御
B	99	一般	加工技術・材料一般		
C	1	OS	精密・超精密位置決め	大橋 康二 (ケーエスエス), 佐藤 海二 (東京工大)	位置決め

分類	コード	OS/一般	セッションテーマ	オーガナイザー	キーワード
C	2	OS	マイクロ/ナノシステム (旧マイクロメカニズム)	大平 文和 (香川大), 堀江 三喜男 (東京工大), 中里 裕一 (日本工大), 伊藤 高廣 (桐蔭横浜大)	マイクロ/ナノシステム, マイクロメカニズム, マイクロマシン, マイクロ加工
C	3	OS	転がり機械要素	下田 博一 (明治大), 清水 茂夫 (明治大), 藤井 健次 (THK)	転がり接触, 転がり疲れ, 転がり軸受, ボールねじ, ボールガイド
C	4	OS	スマートエンジニアリングシステムの設計・応用	古川 正志 (旭川高専), 青村 茂 (東京都立大), 林 朗弘 (九州工大)	群知能機械
C	5	OS	パラレルメカニズム	大岩 孝彰 (静岡大), 武田 行生 (東京工大)	パラレルメカニズム
C	6	OS	圧電アクチュエータとその応用デバイス	古谷 克司 (豊田工大), 岩附 信行 (東京工大)	圧電アクチュエータ
C	7	OS	ロボティクス	青柳 誠司 (関西大), 太田 順 (東京大), 関 啓明 (金沢大)	ロボティクス, メカトロニクス
C	8	OS	プラスチック歯車	高橋 秀雄 (木更津高専)	プラスチック, 歯車
C	99	一般	メカトロニクス・知的システム一般		
D	1	OS	メカノフォトニクス	野村 俊 (富山県立大), 新井 泰彦 (関西大)	光応用技術
D	2	OS	知的精密計測	高増 潔 (東京大), 笹島 和幸 (東工大), 高谷 裕浩 (大阪大), 高 偉 (東北大)	知的計測
D	3	OS	画像応用と知能化システム	村上 俊之 (慶應大), 角田 興俊 (日本アイビーエム)	画像処理と知能化
D	99	一般	計測・品質管理一般		
E	1	OS	医用・人間工学	太田 裕治 (お茶の水女子大), 佐久間 一郎 (東京大)	医用機器, 福祉機器, 人間共存型機器, 生活支援機器
E	99	一般	医用・福祉工学一般		
F	1	OS	生産原論	河西 敏雄 (東京電機大), 伊藤 昌樹 (関東職能開発大), 池野 順一 (埼玉大)	生産原論, 技術者倫理, 技術教育, 技術伝承, 生産哲学
F	99	一般	技術史・教育一般		
G	99	一般	新領域, その他		